

# 电子装联中的无铅焊料



[电子装联中的无铅焊料\\_下载链接1](#)

著者:

出版者:

出版时间:2010-4

装帧:

isbn:9787121106781

《电子装联中的无铅焊料》阐述了现代电子工业发展对软钎焊技术提出的新挑战，揭示

了电子产品无铅化的必然趋势。在此基础上，介绍了国内外无铅钎料研究现状及最新进展，详细介绍了二元无铅钎料、三元及多元无铅钎料的物理性能、力学性能和可靠性等；并对与电子产品可靠性密切相关的界面金属间化合物、无铅钎焊接头可靠性模拟、无铅焊点缺陷、PCB无铅表面处理、器件引脚无铅镀层等问题进行了深入探讨，同时介绍了无铅焊点检测方法及无铅钎料及接头的测试方法和标准。

《电子装联中的无铅焊料》用于材料科学研究及实际生产指导，可作为从事先进电子连接材料研究的科研工作者及工程技术人员的参考书，也可作为材料科学、微电子连接等专业高年级学生或研究生的教学参考书。

作者介绍:

目录:

[电子装联中的无铅焊料\\_下载链接1](#)

标签

评论

-----  
[电子装联中的无铅焊料\\_下载链接1](#)

书评

-----  
[电子装联中的无铅焊料\\_下载链接1](#)